

INHALT

Dezember 2019



1910

Vorteile von H₂: Doosan, auch für PCB-Basismaterialien bekannter Konzern aus Korea, macht eine Drohne mit der Brennstoffzelle langstreckentauglich



1892

Hochstromfeste Schottky-Dioden für Automotive-Anwendungen werden immer kleiner



1898

Mit cloud-basiertem Komponentenmanagement in eine neue Ära der Elektronikentwicklung



1933

Auf der 27. FED-Konferenz gings um den Impact der Megatrends ‚mobil-vernetzt-smart‘

EDITORIAL

2002 Seiten weiter... 1843

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1847
 Innovationsnetzwerk 3D-Elektronik bringt Elektronik in die nächste Dimension 1862
 Vorreiterrolle und Trend zu smarter Produktion bestätigt 1865
 Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1887

BAUELEMENTE

Automotive: 200V-Schottky-Barrier-Dioden mit extrem niedrigen IR 1892
 Bleifreie Arrays erfüllen künftige Umweltvorschriften 1893

BAUELEMENTE

SMD- und Ultraminiatur-Quarze von Mercury neu bei Schukat 1893

DESIGN

Mit Eplan eBuild cloudbasiert zum Schaltplan 1896
 Cloud-basierte Anwendung für eCAD-Komponentenmanagement 1898
 Kompakter Design-Leitfaden für HF- und Mikrowellen-Boards 1901

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrickheit): Wir vernachlässigen die Speichertechnologie H₂ 1911



Global X-Ray & CT-Forum der Firmengruppe Baker Hughes: Voller Highlights und nach mehreren Jahren wieder einmal in Deutschland



In der Entwicklungs-Pipeline der FHG-IKTS: Passende fotostrukturierbare Pasten für bessere Realisierung von 5G-Anwendungen

LEITERPLATTENTECHNIK

JPCA Show 2019: 5G und Automobile sind die großen Treiber – Teil 3: Ausrüstungen 1920

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Megatrend ‚mobil – vernetzt – smart‘ im Blick 1933

ANALYTIK & TEST

Global X-ray & CT Forum 2019 mit vielen Neuheiten 1945

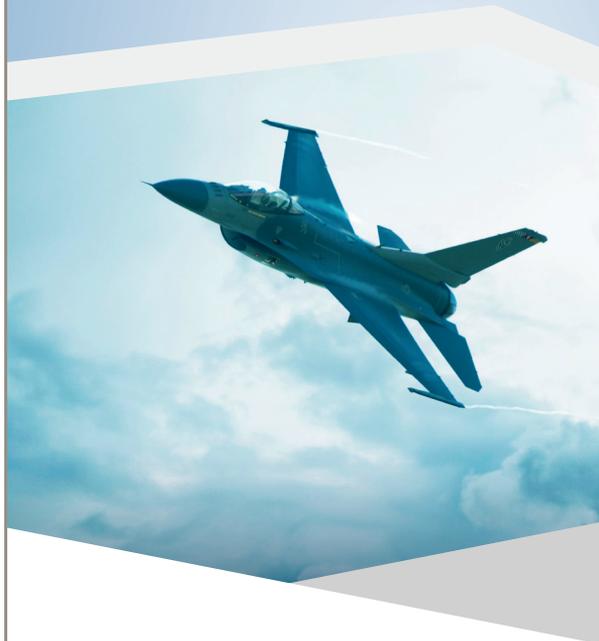
FPT bringt schnellere Verfügung über Baugruppen 1948 ▶

PLUS 12/2019 | 1845



ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

Höchste Qualitätsstandards für Aerospace & Defense durch AS9100 Rev C Zertifizierung



Leiterplattenhersteller aus der Luft- & Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100 Rev C-akkreditierte Lieferkette für hochzuverlässige Basismaterialien und Prepregs. Von der Herstellung bis zur Lieferung ist unser gesamtes qualitativ hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, FR4 und unserer 'tec-speed' Serie von High-Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt. Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com

Follow @VentecLaminates

www.ventec laminates.com



Schrumpfen von Leiterbahnen und Beschichtungen sind keine Zauberei, sondern chemisch erklärbar, sagt Armin Rahn

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Fotostrukturierbare Pasten für 5G-Anwendungen	1952
Patente	1954

FORUM

Bericht aus Dresden: Technologien zum Digitalen Wandel in der Tradition der Computertechnik in Sachsen	1957
Kolumne: Simsalabim	1965
PLUS-Firmenverzeichnis	1969
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1997
Stellenanzeigen / Erinnerungen	1998
Inserentenindex	1999
Mediadaten	2000
Impressum	2001
Produkt des Monats	2002

Titelbild

Die budatec GmbH aus Berlin ist Anlagenhersteller für die Halbleiter- und Solarindustrie. Hauptgeschäftsfelder sind thermische Systeme und Produkte rund um die Elektronikfertigung mit den Schwerpunkten ‚Vakuumlötsysteme‘ und ‚Sintersysteme‘ für definierte Atmosphären, angefangen von kleinen Batch- Anlagen bis hin zu vollautomatisierten Produktionssystemen.

budatec GmbH, Melli-Beese-Straße 28
D-12487 Berlin, Tel.-Nr. +49 (0) 30 - 63 22 40 70
info@budatec.de, www.budatec.de

Die Fachzeitschrift PLUS enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e. V.
Tel. +49 8563 9788908
a.falke@fbdi.de, www.fbdi.de

1894



Fachverband Elektronik-Design e. V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1905



EIPC – Der Europäische Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1916



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1931



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e. V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1938



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e. V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1949



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1955